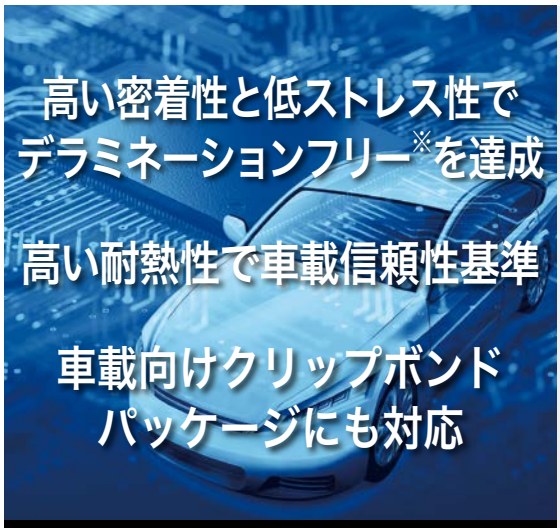
Panasonic INDUSTRY



用途
半導体パッケージ/オートモーティブ
表面実装用 PKG：SOP, QFP, LQFP, DPAK, LFPAK, TOLL

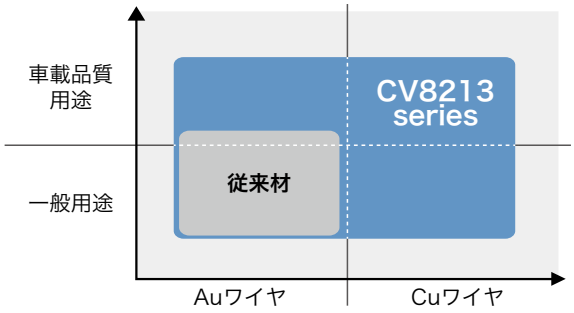
LEXCM CF

CV8213 series

デラミネーションフリー※表面実装封止材

高い密着強度と低ストレス性でデラミネーションフリー※を達成。
車載用途に対応した耐熱性を実現（AEC-Q100/grade 0）

コンセプト

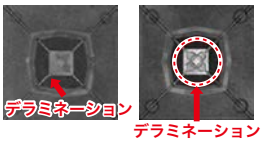


吸湿リフロー試験でデラミネーションフリー※を実現

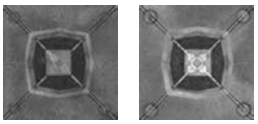
		従来材	CV8213 series
吸湿リフロー試験 (MRT) デラミネーション発生有無	Lead finger	3/6	0/6
	Die paddle	0/6	0/6
	Chip(front)	0/6	0/6
	Chip(back)	5/6	0/6

条件	Level 2aa (85℃/65%RH/120h＋IR(260)×3)
PKGサイズ	28□LQFP 256pin CuL/F die size 6×6×0.35mmt (SiN)
成形条件	180℃/60scure, Injection pressure 9.8MPa, Injection time 7.5s (Out of cure time)

従来材

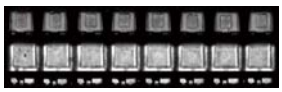


CV8213 series



温度サイクル試験1000サイクルにおいてもデラミネーションの発生無し※

LF surface ：Copper paddle, T post: Ni　　Die Attach : Solder paste
MLS1 ：Moisture Sensitivity Level Tesiting Level1　　TCT ：-65℃⇔175℃

	MSL1 テスト後	500サイクル	1000サイクル
従来材			
CV8213 series			

一般特性

項目	単位	CV8213 series
ガラス転移温度 (Tg)	℃	125
熱膨張係数 (α1/α2)	ppm/℃	10 / 46
曲げ弾性率 (260℃)	GPa	0.4
吸湿率	%	0.13
pH	—	7.0

※ 1. 当社評価サンプルでSAT(超音波探傷装置)を用いた測定方法により、リードフレームと半導体封止材間に剥離部分が検出されないことを表します。
2. あらゆる評価条件下で剥離部分が検出されないことを保証するものではございません。
3. 剥離の発生有無につきましては、お客様ご自身で十分ご評価の上、採用のご判断をお願いします。

商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。　　上記データは当社測定による代表値であり、保証値ではありません。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials
Panasonic Industry CV8213

パナソニック インダストリー株式会社　電子材料事業部

© Panasonic Industry Co., Ltd.　202307